



REFERENTEN

Gerhard Bayer

Fehleranalyse RoodMicrotec GmbH, Stuttgart

Dr. Andreas Braasch

Geschäftsführer Institut für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement GmbH

Jürgen Gruber

Leiter Fehleranalyse RoodMicrotec GmbH, Stuttgart

Prof. Peter Jacob

Ausfall-/Zuverlässigkeitsanalytiker EMPA, Dübendorf

Günter Kohm

RoodMicrotec GmbH, Stuttgart

Dr. Michael Metzle

Leiter Qualität und Service, BPW Bergische Achsen, Wiehl

Dr. Fabian Plinke

Institut für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement GmbH

Daniel Wuhrmann

Rechtsanwalt, Reusch Rechtsanwälte, Berlin

ZIMMERRESERVIERUNG

Ein begrenztes Zimmerkontingent steht Ihnen unter dem Stichwort „RoodMicrotec /IQZ Seminar“ zur Verfügung:

Vienna House Easy Wuppertal

Auf dem Johannisberg 1, 42103 Wuppertal

Tel: +49 202 49670

Preis: € 99,00 für Lounge Zimmer inkl. Frühstück (EZ)

Kontingent gültig bis 26.06.2017

oder

Hotel Park Villa Wuppertal

Erich-Hoepner-Ring 5, 42369 Wuppertal

Tel: +49 202 2833540

Preis: € 120,00 zzgl. € 17,50 Frühstück

Kontingent gültig bis 19.06.2017



VERANSTALTUNGSDetails

Veranstaltungsort: W-tec / Technologiezentrum
Wuppertal W-tec GmbH
Lise-Meitner-Straße 5-9
42119 Wuppertal, Haus 2

Kosten: € 650,00 netto
inklusive Verpflegung und
Seminarunterlagen
für EMPA Mitglieder € 50,00
Ermäßigung

Anmeldung: erika.nagel@roodmicrotec.com
Fax: 0049 711 86709-50
Online-Formular über
www.roodmicrotec.com

Anmeldeschluss: 26.06.2017

Auskunft: RoodMicrotec GmbH
Motorstr. 49, 70499 Stuttgart
Erika Nagel
Telefon +49 (0)711 86709-11
Telefax +49 (0)711 86709-50

TEILNAHME-/RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr ist mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei Stornierung der Anmeldung nach dem 30.06.2017 werden 50% der Teilnahmegebühr fällig, nach dem 03.07.2017 oder bei Nichterscheinen 100%. Eine Ersatzperson kann jederzeit benannt werden.

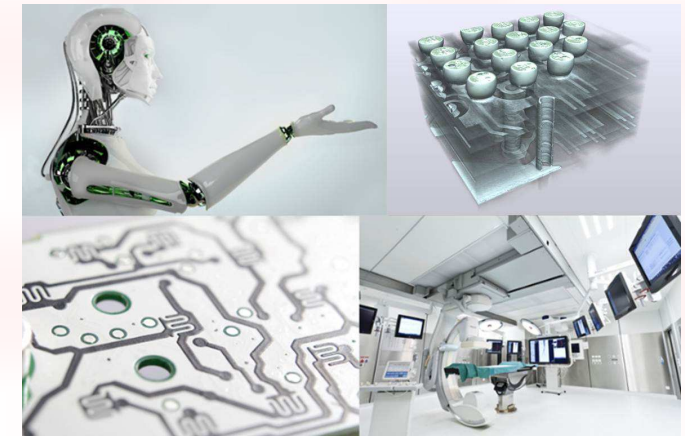
COME TOGETHER:

Am Vorabend um 19:30 Uhr gemeinsames Abendessen und Fachdiskussionen mit unseren Referenten im Wuppertaler Brauhaus, Kleine Flurstr. 5, 42275 Wuppertal, für alle, die Interesse haben. Bitte kündigen Sie Ihre Teilnahme über das Anmeldeformular an. Sie sind herzlich dazu eingeladen.



Einladung zum Seminar am 11.07.2017

Sicherheit und Zuverlässigkeit elektronischer Systeme



„Fehler sind oft die besten Lehrmeister“
*James Anthony Froude



THEMATIK

- Was bedeutet das Thema Sicherheit und Zuverlässigkeit aus rechtlicher Sicht?
- Wie wird Zuverlässigkeit systematisch im Produktentstehungsprozess verortet?
- Welche Informationen lassen sich aus Bauteilanalysen ziehen?
- Wie lässt sich das Risiko bei Feldausfällen bestimmen?
- Fehlerbilder und ihre Interpretation.

Nutzen Sie dieses eintägige Seminar und lassen Sie sich von 7 hochkarätigen Referenten in die herausfordernde Welt der Sicherheit und Zuverlässigkeit elektronischer Systeme entführen.

Kürzere Entwicklungszeiten, hohe Systemkomplexität, verlängerte Garantiezeiträume – das sind die Schlagworte, aus denen sich die Herausforderungen für Hersteller und Zulieferer komplexer Systeme ergeben und denen es sich in heutiger Zeit zu stellen gilt. Immer wieder zeigte sich im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Rückrufe eindrucksvoll, dass nicht alle Systeme vor dem Inverkehrbringen die notwendige Reife hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit erreichen. Verschärft wird diese Thematik durch den Einsatz von Gleichteil- und Plattformstrategien, die auf den ersten Blick durch erhebliche Skaleneffekte attraktiv erscheinen, jedoch hinsichtlich Risikopotential von großen Serienschäden einer ganzheitlichen Risikobetrachtung bedürfen.

Die Anforderungen für die Qualifikation von elektronischen Komponenten und Systemen kann nicht mehr mit Standardtests abgedeckt werden. Es reicht nicht aus, auf eine Null-Fehler Qualifikation zu zielen, sondern man muss über Grenzen hinaus gehen. Wichtige Rückschlüsse auf die Bauteilqualität lassen sich durch Ausfallanalysen erzielen, die eine ganzheitliche Betrachtung erfordern, da Statistiken belegen, dass in ca. 85% der Fälle das Bauteil, Opfer und nicht Ausfallursache ist. Schwerpunktmäßig werden die Probleme an Leiterplatten, Baugruppen, LEDs und Keramikkondensatoren beleuchtet.

ZIELGRUPPE:

Produktmanager, Qualitätsmanager und Entwickler von elektronischen Komponenten sowie Ingenieure und Techniker aus den Gebieten Qualifikation und Zuverlässigkeit.



PROGRAMM

Am Vorabend „come together“ mit Fachdiskussionen, nähere Information siehe **VERANSTALTUNGSDetails**

09:00 - 09:15	Check-in mit Kaffee + Brezeln
09:15 - 09:30	Begrüßung <i>Reinhard Pusch, Andreas Braasch</i>
09:30 – 10:15	Funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit – Rechtliche Schnittstellen und Fallstricke im Kunden- und Außenverhältnis <i>Daniel Wuhrmann</i>
10:15 - 10:45	Zuverlässigkeitsmanagement in der Entwicklung – Best Practice eines Nutzfahrzeugzulieferers <i>Dr. Michael Metzle</i>
10:45 – 11:15	Kaffeepause
11:15 – 11:45	Qualifikation auf Bauteil- und Baugruppenebene <i>Jürgen Gruber</i>
11:45 - 12:30	Fehleranalyse ⇔ Anamnese <i>Prof. Peter Jacob</i>
12:30 - 13:30	Mittagspause
13:30 – 14:00	Keramikkondensatoren: Ausfälle durch mechanische Überlastung sowie Möglichkeiten der Prävention <i>Jürgen Gruber</i>
14:00 - 14:30	Fehlerbilder an Aufbau- und Verbindungstechnik (Leiterplatten) – Lötten, Einpresstechnik, Bondverbindung <i>Gerhard Bayer</i>
14:30 - 15:00	Ausfallanalysen an LEDs <i>Günter Kohm</i>
15:00 - 15:30	Kaffeepause
15:30 - 16:00	Nutzen von Feldinformationen bei Serienschaden und Rückruf <i>Dr. Andreas Braasch</i>
16:00 - 16:30	Neue Sicherheitsbewertungsverfahren für automatisierte Systeme <i>Dr. Fabian Plinke</i>
16:30 - 17:00	Abschluss – Diskussion



ANMELDUNG

Sicherheit und Zuverlässigkeit elektronischer Systeme

Donnerstag 11. 07. 2017, 09:00–17:00 Uhr

Anmeldeschluss: 26.06.2017
erika.nagel@roodmicrotec.com oder
Fax:+49 (0)711 86709-50 oder
Online-Formular über www.roodmicrotec.com

- Ja, ich nehme teil
- Ja, ich nehme am „come together“ teil
- Ja, ich bin Pool-Mitglied der EMPA



Vorname, Name

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Datum Unterschrift